

# 「Connection : BEOL からチップレット、そして未来へ」

エレクトロニクス実装学会との協業シンポジウム

2023年3月16日(木) 09:00 ~ 12:10 E302 (12号館)

先端ロジックやメモリデバイス、パワーデバイス、通信、センサーデバイスなど、More Moore / More Than Moore の両輪で半導体デバイスの高性能化、高機能化が進んでいる。配線システムおよび先端パッケージング技術は、これらデバイスの性能を最大限に引き出し多機能化するための最もクリティカルな技術であり期待と注目が集まっている。本シンポジウムでは過去から現在そして未来を創る配線技術・先端パッケージング技術について講演いただき、我々が挑むべき課題と方向性について議論する。

## 講演プログラム

09:00 ~ 09:30 BEOL 技術の変遷と最近の動向

○上野 和良 (芝浦工大工)

09:30 ~ 10:00 半導体実装工学の重要性と先端パッケージング・システム集積の動向

○福島 誉史 (東北大院工)

10:00 ~ 10:30 マルチ IP SoC によるドメイン・スペシフィック・アクセラレータの NRE コスト削減

○大内 真一 (産総研)

10:30 ~ 10:40 休憩

10:40 ~ 11:10 ウエハレベルハイブリッド接合を用いた 3 次元実装技術

○藤野 真久 (産総研)

11:10 ~ 11:40 3D・チップレット集積のための半導体微細加工技術

○森川 泰宏 (アルバック 先進研)

11:40 ~ 12:10 半導体パッケージング向け先端基板技術の動向

○松木 隆一, 中澤 信司, 大井 淳, 片桐 規貴, 荒木 康 (新光電気工業)

敬称略